

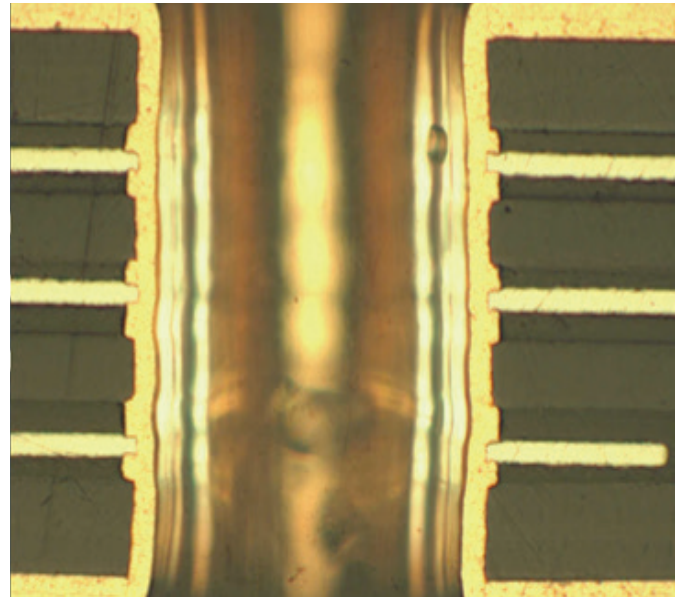
Shadow

石墨系直接电镀

Shadow! 提供最高品质 与最可靠的直接电镀

Shadow是采用专利的弱碱性石墨胶体溶液,用于制作通孔和其它微孔导电层以利后续的铜电镀。

相较于化学沉铜,Shadow工艺可以有效的沉积在各类型高性能的材料上,减少了传统化学沉铜和铜箔之间界面,步骤更少,有效的提高了应用在极端产品上的可靠性。



主要特性优点

- 无需采用昂贵的钯当作催化剂
- 通过最高端的IST, HATS和冷热循环测试, 验证无与伦比的可靠性
- 大量的降低耗电量和用水量
- Shadow 搭配 我司优异的盲孔填孔电镀, 无需闪镀; 大幅改善生产流程和降低生产成本!
- 提供最佳的镀铜、铜箔之间直接的结合强度
- 没有传统化学铜氢产生氢气的气泡问题
- 无螯合剂, 无甲醛, 无重金属
- 只有四个药水槽, 流程简单、易于生产维护
- 兼容市场上所有类型的材料, 如PI, LCP, 软硬结合板, PTFE



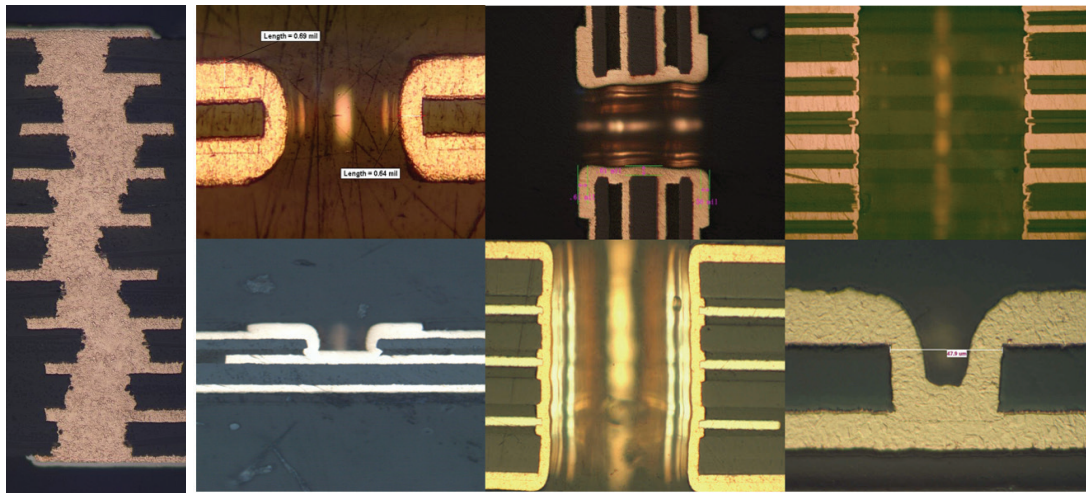
MacDermid Enthone

Shadow

石墨系直接电镀

多层硬板、软硬结合板, 任意层HDI ; Shadow轻松完成!

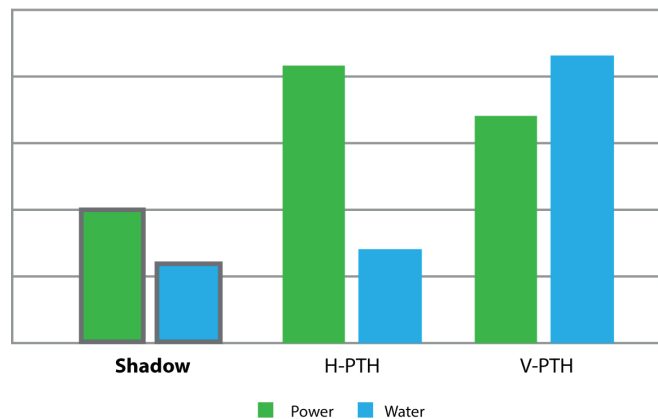
Shadow是目前市占第一名的先进通孔和盲孔金属化的直接电镀系统。无论您是电镀单孔还是堆叠孔, 低或高纵横比通孔, Shadow都能比任何其他金属化工艺更清洁, 更快速, 更可靠。



Shadow能够沉积上化学沉铜和其他直接电镀不能的材料。诸如任意层HDI, 复杂盲孔和高纵横比通孔之类的复杂设计对Shadow技术都不是问题。先进的基板, 如高频印刷电路板材料, PTFE和柔性电路板, 与Shadow工艺完全兼容。

节能、省水的环保工艺!

电和水的消耗量



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS